

iSpindel hobipivo PCB Versionen

Version 2.0 (Mai 2021)

Mit optionalem elektronischen Verpolungsschutz:

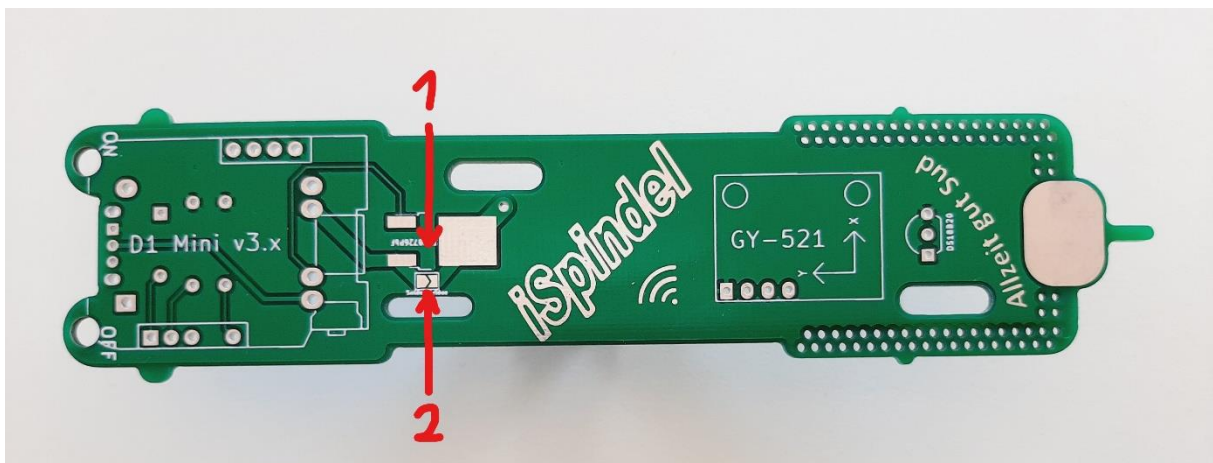
- Verwendung von N-CH MOSFET IRLR8726PBF im TO-252AA Gehäuse
- Platzierung von Lötbrücke zur möglichen Überbrückung, wenn der Verpolungsschutz nicht verwendet werden sollte

Entfernung der zusätzlichen Reset-Funktion

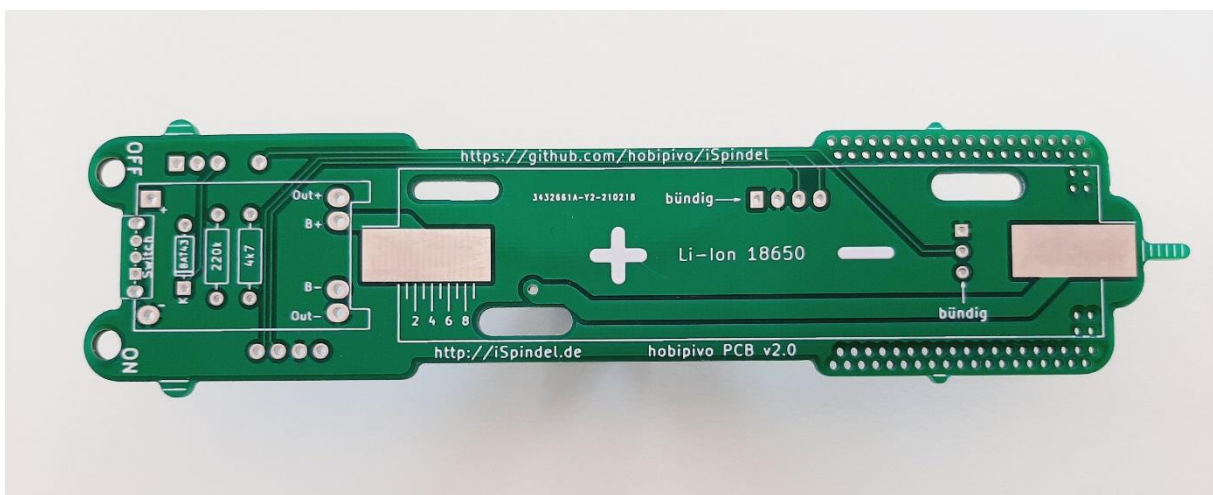
Abstandserweiterung der DS18B20 Lötpins

Zusätzliche Abstandshalter

Zusätzliche Beschriftung und Feinanpassungen



- 1 > SMD Lötpads für N-CH MOSFET Transistor im SOT-252AA oder SOT-223 Gehäuse
2 > Lötbrücke (falls der Verpolungsschutz-Transistor nicht verwendet wird)



Version 1.0 (Jänner 2021)

Die v1.0 Platine dient als Prototyp für v2.0

In Anlehnung ans Jeffrey Board wurde dieses um folgende Punkte geändert/erweitert:

- Erweiterung/Änderung der Platinen-Führungsnasen im PETling
- Aufdruck von gut sichtbaren + - Zeichen für den Akkueinbau
- Änderung der Widerstandspositionen (keine zusätzlichen Durchkontaktierungen)
- Verschiebung des D1 mini Modules näher Richtung Deckel
(Lötstellen von Lademodul beim Wemos nicht mehr im Weg)
- Verschiebung und Änderung des Lademoduls Footprints (Pin-Abstände)
- Änderung des Styles und Position des GY-521 Footprints
- Aufgeräumte Beschriftung
- Verwendung von Kupferplanes für VCC und GND

